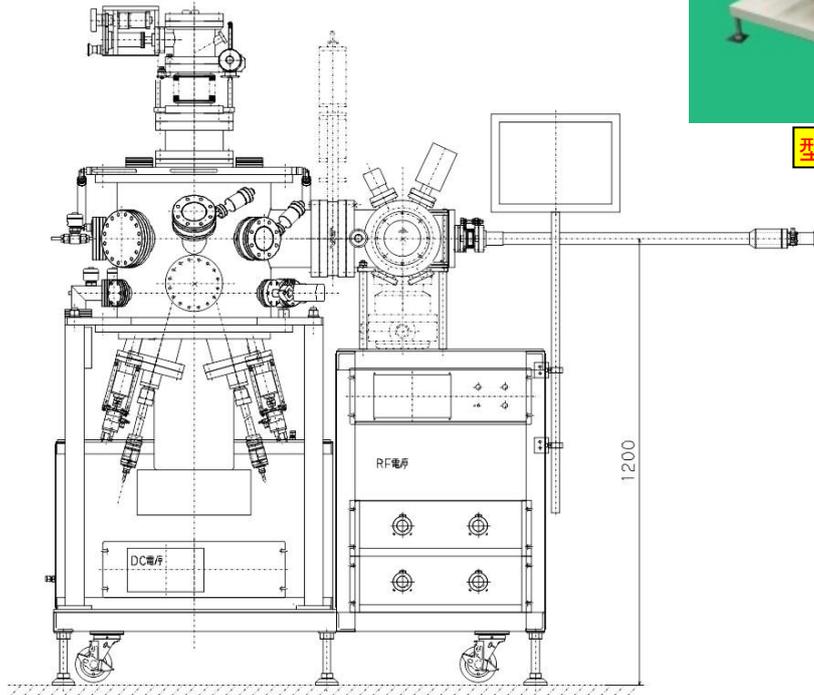


スパッタ装置

Sputtering System



型式: ASP-323-1



装置の詳細仕様、バリエーションに関してはお気軽にお問い合わせ下さい。

装置名称	スパッタ 装置 (スタンダード)	備考
型式	ASP-323-1 (成膜室+準備室)	
仕様	成膜室: 寸法380(ID)X400(H) mm, G.B.B処理	水冷パイプ巻き
	スパッタ源: $\phi 2'' \times 3$ 元, マグネトロン水冷式	自動シャッター付
	電源: RF電源500W、自動マッチング付 1台 DC電源 800V 1000W 1台	切替により電源を供給 電源容量方式選択可能
	基板: サイズ $\phi 3''$, ランプ加熱, 温度500以上	Z軸駆動器S=100付
	成膜室真空度: 5×10^{-5} Pa以下	ポンプ組合せ選択可能
	ガス導入系: MFC+ストップバルブ, 3系統	必要に応じて変更可能
設置及電源	準備室: 真空度 5×10^{-5} Pa以下, ロードロック機構	補助ポンプ共用
	外観寸法: 150(W)X120(D)X180(H) cm 電源: 単相 200V 60A	

株式会社 アンセイテック ANSEI TECH CO., LTD.
 TEL: 06-6707-5888 E-mail: info@anseitech.com